Customer:

No. SW103086A

Date: Apr. 20. 2010

ALPS EUROPE DISTRIBUTION

Attention:

Your ref. No.:

Your Part No.: SSAJ120100

SPECIFICATION

ALPS';

MODEL: SSAJ120100

Spec. No.: SSAJ-S-001

Sample No.: F9709025M

RECEIPT STATUS
RECEIVED
By Date
Signature
Name



DSG' D M. Hayashi

ENG. DEPT.

Sales

Head Office 1-7, Yukigaya-otsukamachi, Ota-ku, Tokyo. 145-8501 Japan Phone. +81 (3) 3726-1211

DOCUMENT No.			TITL	E			PF	RODU	СТ	SPECIF	ICAT	TIONS					PAGE	
SSAJ-S-001							李	Ä Y	品	仕	様						1	/ 5
BACKGROUND																		
																		(標準)
1. Ger	neral	一般事項	<u>l</u>											_				
1.2 C	torage	tion 適用氧 ng temperature temperature ra nditions 試験	こ(range inge 伏態 Ur 影	の仕様温 使保記 less ot 以 Rel Air nould an だし、半 Am Rel	書は主 接範囲 herwise 測定は ibient t lative h pressu ny doub	として¶: -10 目: -4 目: -4 e specifi k特に規 empera umidity ire ot arise empera umidity	電子機器 0 ~ 8 fied, the Reconstitute in judg EUC ture	器0°℃ at NBL 相気 pend pend pend pend pend pend pend pend	ハる spher by	t電流回路 ic conditi の標準状 5~35℃ 25~85% 86~106kl	格用(ions fo 大態の Pa cond 態で行	2次側回路 or making もとで行う lucted at t	所)ス・ measur 。	ライドス ements	イッチ(s and te	for electronic eq 二適用する。 ests are as follov ns.		
		e, construction ance 外観	and dimensi	ons	Swite	構造、 ch shall	l have a	good fi	nishin	g, and no	rust,	crack or p	plating (ailures				
2.2 C	onstru	ction and dimen	ısions 樺	造、寸	法							易、割れ、8 別製品図			刺離等	ទがあってはなら	ない。	
3.Ratii	ng 定	格																
				最大定 最小定								(抵抗負荷)(抵抗負荷						
4. Elec	trical s	specification 1	电気的性能															
	Iter	ms 項目			Te	st con	ditions		1	試験条	と 件					Crit	eria 判定:	基 準
4.1		act resistance ! 抵 抗	Shall be n 1 kHz±20										ける。			300mΩ		
4.2	Insula	ntion	Test volta	ge: _1	00 V	DC, me	easure o	d after	1 min	± 5 s						100 MΩ N	MIN	
	resist 紹 紹	ance と抵抗	Applied po	sition:						. ,								
	小二 神男	K 743. 171.	DC_100	V の電	Betwe 配圧を 1	een terr 分士5	minals a 砂間端·	and gro 子相互	und(f 間、站	rame) 尚子フレー	-ム間	に印加し、	測定す	·る。				
耐電圧 Duration: 1 min Applied position:			Betwe Betwe	een all t	termina minals a	ıls and gro	und(f			相互間、端	子フレ	一厶間	ĸ	No dielectric b 絶縁破壊のな	reakdown shall d いこと。	occur.		
4.4 Changeover timing 切換タイミング					1	dual product drav	wing.											
5. Med		specification	機械的性能	<u></u>												個別製品図に	よる。	
	Iter					st con				试 験 条	_					Crit	eria 判定。	基 準
5.1	Opera 作 重	ating force カカ	A static lo 操作部の							Refer to individual product drawing. 剛定する。 「日本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			ving.					
5.2	Robus	stness of	A static lo	ad of_	3 N	shall b	e appli	ed to t	ne tip	of termin	nal in	a desired	direction	n		Shall be free fr	om terminal loos	seness.
	termir 端 -	nal 子強度	for 1 min. The test shall be done once per terminal. 端子先端の一方向へ <u>3 N</u> の静荷重を1分間加える。 ただし、回数は1端子当たり1回とする。 は in item 4 shall be satisfied. 端子の脱落、破損及び端子保持部のないこと。ただし、端子の曲がりは差しいものとする。また、試験後 4項の質性能を満足すること。			after test. nent specified. 寺部の破損の は差し支えな												
5.3	actua		A static lo 操作部の	ad of_ 作動方	10 N 向に	_ shall 10 N	be appl の静花	lied in t 苛重を1	he op 5秒間	perating d 引加える。	lirecti	ion of actu	ator fo	deformation and mechanical abnormal			normalities.	
			著しいガタ及び曲がりのないこと。 static load of 10 N shall be applied in the pull direction of actuator for 15 s. 作部の引張方向に 10 N の静荷重を15秒間加える。							-								
at			at the tip	static load of <u>1 N</u> shall be applied in the perpendicular direction of operation the tip of actuator for 15 s. 作部の先端に作動方向と直角に <u>1 N</u> の静荷重を15秒間加える。														
														_		APPD.	CHKD.	DSGD.
											\dashv					Aug.5,2009	Aug.5,2009	Aug.5,2009
PAGE	SYMB	BACKGROUND	DATE	APPD	CHKD	DSGD	PAGE	SYMB	ВА	CKGROUNI	D	DATE	APPD	CHKD	DSGD	T.Kawase	T.Itabashi	M.Hayashi

DOC	JMENT No.	Ti	ITLE PRODUCT SPECIFICATIONS		PAGE
s	SAJ-S-001		製品仕様書		
			25 HI II 138 T		2/5
	Items 項目	$+$ \perp	T		
5.4	Wobble of actuator	Run-o	Test conditions 試験条件 out(P-P) shall be measured by applying a static load of 1Nin the	Criteria	
	操作部の振れ	perper	ndicular direction of operation at the tip of actuator.	P-P:1_mr	n MAX
		操作部	形の先端に作動方向と直角に 1Nの静荷重を加え、振れ幅(最大値)を測定する。		
<u> </u>					
5.5	Vibration 耐 振 性	Switch	n shall be secured to a testing machine by a normal mounting device and method. n shall be measured after following test.		e 接触抵抗 (Item 4.1):
	177 LT	スイツ	チを正規の取付用具、取付方法で試験機に固定し、下記条件で試験を行い、		_mΩ MAX nce 絶縁抵抗(Item 4.2):
		試験後	後測定する。		MΩ MIN
			ration frequency range 振動数範囲: 10~55 Hz	Voltage proof	-
<u> </u>		1 '	al amplitude 全振幅: 1.5 mm eep ratio 掃引の割合: 10-55-10 Hz Approx. 1 min 約1分		100 V AC for 1 min.
		F	eep ratio		ric breakdown shall occur. かないこと。
		掃	引振動数の変化方法 対数又は直線近似		//ふいこと。 作動力 (Item 5.1):
			ection of vibration: Three perpendicular directions including actuator		cified value.
		坂! (6)Dura	動の方向 操作部を含む垂直3方向 ation 振動時間:2 h each (6 h in total) 各 2時間 (計 6時間)	規格値内	
		(O)Bur	udon pkaypyjaj. 2 n each (Un in Cotal) 仁 Zbyjaj (高 Obyjaj)	機械的に異常がた	mechanical abnormalities.
				We want of Care to 10 and	× · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
5.6	Shock		shall be measured after following test.	Contact resistance	e 接触抵抗 (Item 4.1):
	耐衝撃性 		や件で試験を行い、試験後測定する。 unting method 取付方法:Normal mounting method		mΩ MAX
		(1),,,,,	正規の方法で取り付ける。		ice 絶縁抵抗(Item 4.2): MΩ MIN
		(2)Acc	eleration 加速度:980 m/s ²	Voltage proof 面	•
		(3)Dura	7	Apply	100 V AC for 1 min.
			t direction 試験方向:6 directions 6 面 nber of shocks 試験回数:3 times per direction		ic breakdown shall occur.
		Onun	inder of snocks attorn (18 times in total)	絶縁破壊の	りないこと。 作動力 (Item 5.1):
			(10 daniel in codal)	Within speci	
				規格値内と	∸する。
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		mechanical abnormalities.
				機械的に異常がな	はいこと。
5.7	Solderability	Switch	shall be checked after following test.	More than 90 %	of immersed part shall be
	はんだ付け性		件で試験を行い、試験後確認する。	covered with sold	er.
		(1)Sold	der はんだ: Sn-3.0Ag-0.5Cu こ フラックス: Rosin flux (JIS K 5902) having a nominal composition of 25% solids		nall not be applied.
		(Z) lux	by mass of water white rosin in 2-propanol (JIS K 8839) solution.	浸漬した部分の_9 一覆われていること	<u>30</u> %以上がはんだで
			ロジン(JIS K 5902)の2-プロパノール(JIS K 8839)溶液とし、	ただし、破断面は	
		/->-	濃度は質量比ロジン約25%とする。		
			dering temperature(はんだ温度:245±5 ℃ mersing time 漫漬時間:5±1 s		
			ix immersing time shall be 5~10 s in normal room temperature.		
		<i>t=t</i>	だし、フラックス浸漬は常温で 5~10 秒とする。		
i		_	nersion depth: Immersion depth shall be at copper plating portion for		
		浸流	濱深さ P.C.Board terminal after mounting. Thickness of P.C.Board: 1.6 mm		
			Immersion depth shall be at wiring portion of lead wire for		
			lead wire terminal.		
			プリント基板用端子はプリント基板(t1.6)実装後、銅箔面まで浸漬。		
			リード配線用端子は端子のリード線からげ部を浸漬。		
					·
					1
.					· ·

(SL)

DOC	JMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	T ₁	(SL PAGE
s	SAJ-S-001	製品仕様音		
		THE TAX BE		3/5
	Items 項目	T I III ED ED ED H		
5.8	Resistance to	Test conditions 試験条件 The test shall be conducted under the following conditions.	Criteria	判定基準
5.0	soldering heat	下記条件で試験を行う。	No abnormalities sh	
1	はんだ耐熱性	I HOW II COMME 1176		eration. The electrical
		Re-flow soldering リフローはんだの場合	4 shall be satisfied.	ements specified in item
		Temperature is measured at surface of switch.	外観に著しい変形の	Dないこと。
		温度は製品上面で測定する。		なく、4項の電気的性能を
		Peak ピーク: 260℃, 3sec MAX 温度プロファイル 2回リフローとする。 但し、1回リフロー後 学習に戻すこと	満足すること。	
		一一 こうしゅ こうじゅ こうい 日 ファー は、 帝風に次うこと。		
	ļ	Temperature 温度(°C)		
		300—	1	
		230°C 3s MAX		
		200—		
		180°C		
		100		
İ				
1		V TIME 時間		
		2min MAX		
		Pre-heating 予熱 40s MAX		
	-	The specimen shall be passed through the re-flow furnace.		
		The specimen shall be passed through the re-now furnace.		
		The specimen shall be stored at standard atmospheric conditions for 1 h after which		
		The measurement shall be make.		
		リフロー炉に通して、常温常湿中に1時間放置後測定する。		
		Manual sold		
		Manual soldering 手はんだの場合 Wattage of soldering iron こて容量:50 W		
		Diameter of soldering iron tip こて先径: φ1 mm		
		Temperature of soldering iron tip こて先温度:350±5℃		
		Soldering time はんだ付け時間:3S MAX		
		Above conditions shall be applied to Glass fabric base, epoxy resin P.C.B of 1.6 mm thick.		
		Soldering iron shall be put at the tip of terminals and prevented excessive force to the terminals.		
		上記の条件は、t1.6 mm のガラス基材エポキシ樹脂積層板について適用する。		
		また、はんだごては端子先端に当て、端子に異常加圧のないこと。		
6.Dura	bility 耐久性能			
0.001 a	Items 項目	Test conditions 試験条件	T	Not the state
6.1	Operating life	Switch shall be operated 10,000 cycles at 15~20 cycles/min without load.	Contract registeres	判 定 基 準 接触抵抗 (Item 4.1):
	without load	無負荷にて10,000サイクル(動作速度15~20サイクル/分)連続動作を行う。		按照规机(Item 4.1): nΩ MAX
	無負荷寿命			e. Measured at DC 100V.
				/: 10 MΩ MIN
			Voltage proof 耐電	图压 (Item 4.3):
				00_V AC for 1 min.
		•	1	breakdown shall occur.
			絶縁破壊の	
			Operating force 11	F劉刀」(Item 5.1): % of specified value.
			Within _30 規格値の ±	
			appearance and cor	-
			外観、構造に異常か	
		Switch shall be operated 10,000 cycles at 15~20 cycles/min with 5 V DC 10 mA.		接触抵抗 (Item 4.1):
	with load 負荷寿命	(Resistive load) DC_5_V, 10_mA(抵抗負荷)にて10,000サイクル(動作速度15~20サイクル/分)		Ω ΜΑΧ
		DC_5_VIO		e. Measured at DC 100V.
			地緣抵抗 DC 100V	/: <u>10</u> MΩ MIN \$1开 (Item 4.3):
				10 VAC for 1 min.
				breakdown shall occur.
			絶縁破壊の	
			Operating force 作	動力 (Item 5.1):
			Within +10	% of specified value
			規格値の 🚉	10 % 以内。
			No abnormalities sh	all be recognized in
			appearance and con	
			外観、構造に異常か	いないこと。
ALPS	ELECTRIC CO.,LTD.			

DOC	UMENT No.	TITLE PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
s	SAJ-S-001	製品仕様書	4/5
7.Env	ironmental test 耐候		
7.1	Items 項目 Cold	Test conditions 試験条件 After testing at -40±2°C for 96h, the switch shall be allowed to stand under	Criteria 判定基準
	耐寒性	After testing at -40±2 C for 90n, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed. -40±2°Cにて96時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。ただし、水滴は取り除く。	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):300 _m Ω MAX Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 4.2):100 _M Ω MIN Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3): Apply100V AC for 1 min. No dielectric breakdown shall occur. 絶縁破壊のないこと。 Operating force 作動力 (Item 5.1): Within30 % of specified value
7.2	Destart		規格値の ±30 % 以内。 No abnormalities shall be recognized in appearance and construction. 外観、構造に異常がないこと。
	Dry heat 耐 熱 性	After testing at 85±2℃ for 96h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. 85±2℃にて96時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
7.3	Damp heat 耐湿性	After testing at 40±2°C and 90~95%RH for 96h, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and then measurement shall be made within 1 h. Water drops shall be removed. 40±2°C、相対湿度90~95%にて96時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。ただし、水滴は取り除く。	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):
7.4	Thermal shock ヒートショック Damp heat with load	After 5 cycles of following conditions, the switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement shall be made within 1 h after that. Water drops shall be removed. 下記条件で5サイクル試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。ただし、水滴は取り除く。 85±2℃ Normal room Temperature 常温 -40±3℃ 30min 30min 2~3min 1 cycle DC voltage 1.5 times as much as rated voltage shall be applied continuously between adjacent	Contact resistance 接触抵抗 (Item 4.1):300mΩ MAX Insulation resistance 絶縁抵抗(Item 4.2):100MΩ MIN Voltage proof 耐電圧 (Item 4.3):Apply100V AC for 1 minNo dielectric breakdown shall occur
	(Resistance to silver migration) 耐 湿 負 荷 (耐銀マイク・レーション 特性)	terminals at 60±2°C and 90~95%RH. After 500 h testing, switch shall be allowed to stand under normal room temperature and humidity conditions for 1 h, and measurement shall be made within 1 h after that. Water drops shall be removed. 60±2°C、相対湿度90~95%にて隣接端子間に定格電圧の1.5倍の直流電圧を連続印加し、500時間試験後、常温常湿中に1時間放置し1時間以内に測定する。ただし、水滴は取り除く。	10 MΩ MIN Voltage proof 耐電圧: Apply 100V AC for 1 min. No dielectric breakdown shall occur. AC 100V、1分間印加。 絶縁破壊のないこと。
ALPS	ELECTRIC CO.,LTD.		L

DOCUMENT No.	TITLE		(SL)
DOCCIVILIA 1 NO.	TITLE	PRODUCT SPECIFICATIONS	PAGE
SSAJ-S-001		製品仕様書	5/5

【Precaution in use】 ご使用上の注意

A.General 一般項目

A1. This product has been designed and manufactured for general electronic devices, such as audio devices, visual devices, home electronics, information devices and communication devices. In case this product is used for more sophisticated equipment requiring higher safety and reliability, such as life support system, space & aviation devices, disaster prevention & security system, please make verification of conformity or check on us for the details. It is prohibited to use this product for flight control purposes in avionics applications.

本製品はオーディオ機器,映像機器,家電機器,情報機器,通信機器などの一般電子機器用に設計・製造したものです。生命維持装置,宇宙・航空機器,防災・防犯 機器 などの高度な安全性や信頼性が求められる用途に使用される場合は、貴社にて適合性の確認を頂くか、当社へご確認ください。 航空機器の運航に関わる部分へは使用にならないでください。

A2. This product is designed and manufactured assuming that it is to be used with the resistance for direct current. If you use other kinds of resistance (inductive (L) or capacitive (C)), please let us know beforehand.

本製品は直流の抵抗負荷を想定して設計・製造されています。その他の負荷(誘導性負荷(L), 容量性負荷(C))で使用される場合は、別途ご相談ください。

- B. Soldering and assemble to P.C.Board process はんだ付, 基板実装工程
- B1. Note that if the load is applied to the terminals during soldering they might suffer deformation and defects in electrical performance. 端子をはんだ付けされる場合、端子に荷重が加わりますと条件によりガタ、変形及び電気的特性劣化のおそれがありますのでご注意下さい。
- B2. Use of water-soluble soldering flux shall be avoided because it may cause corrosion of the switch. はんだ付けの際、水溶性フラックスはスイッチを腐食させるおせれがありますのでご使用はお避けください。
- Condition of re-flow soldering flux shall be confirmed with actual production conditions. リフローはんだ条件の設定については、実際の量産条件で確認されるようお願いします。
- B4.As this switch is designed for re-flow soldering, if youtplace it at the edge of PCB for convenience, then flux may get into the sliding. 当スイッチはリフローはんだ対応ですが、スイッチ実装後にオートディップを行う場合にスイッチが基板の端にあるとフラックスが侵入する恐れがありますので、 十分にご注意ください。
- B5. Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. はんだ付け後、溶剤等でスイッチを洗浄しないでください。
- B6. When soldering, slide should be at the P position in product drawing. はんだ付けの際、スライドのつまみを製品図と同位置に移動させてはんだ付け下さい。

C.Mechanism design(switch layout) 機構設計

- C1. Excessive operating force over specified value shall be avoided to the actuator because it is small and weak. 操作部は小さいため強度が弱くなっておりますので、操作部に規格値以上の力が加わらないようにご配慮下さい。
- C2. Designing printed pattern and parts layout shall be considered because the characteristics may change due to warp of P.C.Board. 基板のソリによって特性が変化する場合がありますので、パターン設計・レイアウトについては十分考慮願います。
- C3. Note that the pattern or resist from on the switch mounting surface of the P.C.B may have an effect on the soldering because of those thickness. スイッチ取付面にあたるプリント基板のパターンやレジストの形状により、その厚み分が半田付け性に影響する場合がありえますのでご注意願います。

D. Using environment 使用環境

D1. Foreign matter invaded from outside. 外部浸入物

Since this switch does not have sealed structure, it may have contact failure caused by the dust from outside up to the environment. 当スイッチは完全密閉構造ではありませんので、使用環境によっては塵埃が内部に侵入し、接点障害を起こす場合があります。

When you use this switch, precaution must be taken against the dust. The followings are examples of dust invasion: ご使用の際はスイッチに異物が侵入しないようにご注意下さい。 以下に塵埃侵入例を示します。ご参考にして下さい。

(1)Debris from the cut or hole of PCB in process, or wastes from the PCB protection material (e.g. newspaper, foamed polystyrene etc.) invaded the switch. 工程内におけるPCB切断面や穴から発生するクズやPCB保護材(新聞紙,発泡スチロール等)から出るゴミがスイッチに侵入した。

(2) Flux or powdered flux produced by stacking PCB's or excess foaming invaded the switch.

基板重ねによりフラックス粉末がスイッチに侵入した。

D2. If you use this product in one of the following environmental conditions, progress of sulfuratio and oxidization on the contact part will be accelerated, which may cause contact failure. Therefore, be careful about the supposed environment.

以下の様な環境下で使用されますと、当製品の性能に影響を及ぼすおそれがありますので使用環境に十分にご注意下さい。

- (1) Around a sulfurate hot spring where sulfide gas is generated. And in case this product is always used in a place where exhaust gas from automobiles exist. 硫黄系温泉地等常時ガスが発生する場所や、自動車等の排気ガスの発生する場所で常時使用する場合
- (2) Follow the directions if you have parts/materials described below within the module where the switch is installed.

同一セット内に以下のような部材に関しましては以下の点にご注意願います。

For parts, rubber materials, adhesive agents, plywood, packing materials and lubricant used for the mechanical part of the device, do not use those ones that may generate gas of sulfurization or oxidization. 部品,ゴム材料,接着剤,合板,機器の梱包材,機器内の駆動部に使用される潤滑剤については、硫化,酸化ガスを発生しないものを採用して下さい。

E. Storage method. 保管方法

E1. If you don't use the product immediately, store it as delivered in the following environment: with neither direct sunshine nor corrosive gas and in normal temperatures. However, it is recommended that you should use it as soon as possible before six months pass.

製品は納入形態のまま常温,常湿で直射日光の当たらず腐食性ガスが発生しない場所に保管し納入から6ヶ月以内を限度として出来るだけ早くご使用下さい。

E2. After you break the seal, you should put the remaining in a plastic bag to separate it from the outside and store it in the same environment mentioned above. You should use it up as soon as possible.

開封後はポリ袋で外気との遮断を図り上記と同じ環境下で保管しすみやかにご使用下さい。

- F1. Please understand that the specifications other than electric and mechanical characteristics and outside dimensions may be changed at our own direction. 電気的,機械的特性,外観寸法および取付寸法以外につきましては、当社の都合により変更させて頂く事が有りますので,あらかじめご了承下さい。
- F2. It is recommended to install a protective or redundant circuit, or to perform safety tests when you use the switches for the equipment requiring expensive safety, whatever purposes the equipment is applied for.

用途の如何にかかわらず、高い安全性が求められる機器にお使いになるときは、保護回路や冗長回路を設けて機器の安全を図られると同時に、お得意先において 安全性のテストをされることをお勧めします。

F3. Though we are confident in switch quality, we cannot deny the possibility that they could fail due to short or open circuit. Therefore, if you use a switch for a product requiring special safety, we would like you to verify in advance what effects your module would receive in case the switch alone should fail. And secure safety as a whole system by introducing that fail-safe design, i.e. a protection network.

スイッチの品質には万全を尽くしてますが故障モードとしてショート、オープンの発生が皆無とは言えません。安全性が重視されるセットの設計に際しては、SWの単品 故障にたいしてセットとしての影響を事前にご検討いただき、保護回路等のフェールセーフ設計のご検討を十分に行い安全を確保して頂きますようにお願いします。

DOCUMENT No.	TITLE	PAGE
TAPE-S-007	Specification of taping package for switches	1/2
	スイッチテーピング仕様書	

1.適用範囲 Scope

本仕様書はスイッチのテーピング包装について適用する。

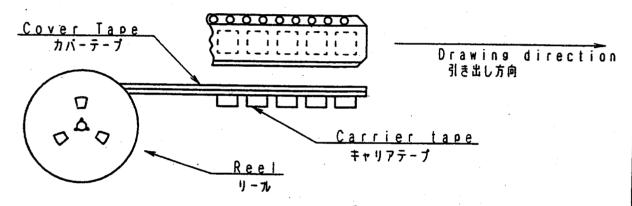
This specification outlines engineering information of the taping package for switches.

2. 部品構成 Construction

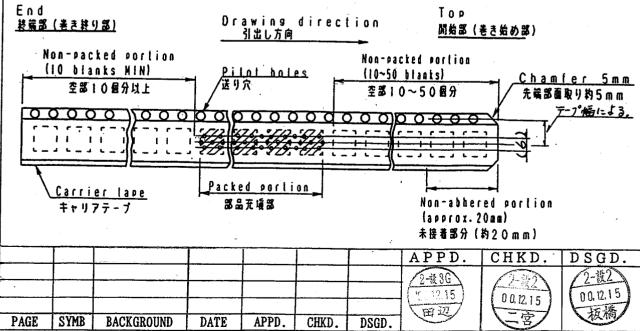
包装仕様書名	部品名				
Package specification	Part				
	リール Reel				
テーヒ°ンク゛ Taping	キャリアテーフ。 Carrier tape				
· .	カハ゛ーテーフ。 Cover tape				

3.寸法 Dimensione 製品図による。 Refer to product drawing

4.テーピングの形態 Taping package form
(1) リールへのキャリアテープ巻き方向はテープ引出し方向に対し,送り穴が右側になるようにする事。
Pilot hole of carrier tape shall be located in the right sade of drawing direction.



(2) リールからの引出し方向に対して最始部,最後部の処理は下図の通りとする。 Deteil of both ends of tape shall be as follows.



ALPS ELECTRIC CO., LTD.

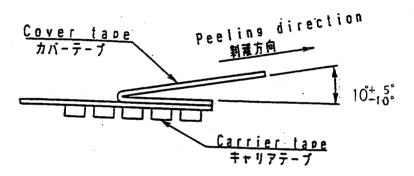
DOCUMENT No. TITLE
TAPE-S-007 Specification of taping package for switches 2/2
スイッチテーヒャング・仕様書

- (3) カパーテープは送り穴をふさいだり、キャリアテープからはみ出してはならない。
 Caver tape shall not close the pilot holes or protrude from the carrier tape.
- (4) スイサの包装欠品はあってはならない。
 There shall be no lack in packing.
- (5) リールへは下記項目を表示する。
 Following items shall be marked on the reel.

Your part NO. 貴社部品番号 Our model No. 当社製品番号 Quantity.数量 Production lot.製造Dyl

5.性能 Performance

(1) カパーテープの剥離強度 Peeling strenght of cover tape カハ・ーテープの剥離強度は、テープ幅8mmの場合は0.1~1.0N、テープ幅12~56mmの場合は0.1~1.3Nとし、試験方法は下図による。
Peeling strength of cover tape shall be 0.1 to 1.0 N for tape width 8 mm, and 0.1 to 1.3 N for tape width 12 to 56 mm, and tested as follows.



- *カバーテープの剥離速度は300±10mm/分とする。
- * Peeling speed of cover shall be 300±10mm/min.
- (2) テーピングの最小曲げ半径 Minimun bending radius of taping package. テーピングの最小曲げ半径は25㎜でスイッチの脱落やテーピングの損傷等の無い事。尚,最小曲げ回数は1回とする。

Falling off of the switch or breakage of taping package shall not occur at minimum bending radius of 25mm.

Minimum bending shall perforemed one time at on position.

(3) カパーテープへのスイーチの付着 Adhesion of the switch on cover tape カパーテープの剥離強度試験と同じようにカバーテープを剥離した際,スイーチがカバーテープに付着しない事。 Switch shall not adhere to the cover tape this test.

